請創作人(發明人)選填：

□服務本人的技術經理是\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

□不知道(或忘記)服務本人的技術經理，請企業關係與技轉中心代填\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**國立成功大學研發成果推廣申請表**

**暨**

**專利費用分攤同意書**

**本案之申請階段擬參加 「優質專利徵選活動」**

**□有意願 □沒有意願**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 研發成果編號： | **110-000** | (由企業關係與技轉中心填寫) |
| 技術名稱： |  | |
| 創作(發明)人代表： | **00**系/所 **000**教授 | |
| 成果歸屬： |  | (由企業關係與技轉中心填寫) |
| 承辦人員： |  | (由企業關係與技轉中心填寫) |
| 收件日期： |  | (由企業關係與技轉中心填寫) |
| 修訂日期(版本)： |  | (由企業關係與技轉中心填寫) |
| 填表目的： | ■ 申請專利 □ 技術推廣 | (可複選) |

※填畢請將本表電子檔傳至企業關係與技轉中心即可([z10009011@email.ncku.edu.tw](mailto:z10009011@email.ncku.edu.tw))※

國立成功大學研發成果專利費用分攤同意書

**欲參加優質專利徵選活動者，本頁暫不須填**

填表日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

研發成果編號：(由企業關係與技轉中心填寫)

技術名稱：

創作人代表：成功大學 系/所 教授

※以「國立成功大學」為申請權人※

本案發明團隊(以下簡稱甲方)同意本案由成功大學企業關係與技轉中心(以下簡稱乙方)代為委託\_\_\_\_\_\_\_\_\_事務所(由乙方填寫)辦理專利申請送件，並依照本校研究發展成果管理辦法及相關規定，請甲方出資費用由乙方繳納應付之專利相關費用(包含但不限於申請、答辯申覆、領證、年費以及讓與…等)予該事務所。

甲方接獲乙方繳費通知後，甲方應於通知期限內完成繳款作業，乙方始進行向智財局申請專利；若甲方未依約繳納相關費用，乙方得暫停該專利案件流程作業，待甲方完成繳納始恢復並進行專利送件作業。

甲方依本同意書應繳納之費用，得由第三人代為履行，若第三人未繳納者，應由甲方自行履行本約定。本同意書經簽章後生效。

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

創作人分攤比例：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 無/其他資助機關 | 科技部計畫成果 | | 備註 |
| 創作人 | 創作人 | 科技部 | 1. 中國大陸、美國臨時案(PA)、PCT、新型及設計專利之費用，不屬科技部可補助範疇，故採用**無/其他資助機關**欄位之比例。 2. 創作人需同意在技轉有權利金收入時，先完成所有必要成本之歸墊，包含科技部之補助款，再行所得分配。 |
| 100% | 40% | 60% |

□甲方同意依分攤比例 %，申請 (國別) 專利。

□甲方同意依分攤比例 %，申請 (國別) 專利。

□甲方同意依分攤比例 %，申請 (國別) 專利。

□甲方同意依分攤比例 %，申請 (國別) 專利。

□甲方在選擇**完全自費**之情況下**因考量專利案處理時效(理由□期刊已(或預計)於\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_投稿，或□其他理由\_\_\_\_\_\_\_)，同意自行完成專利前案檢索並將資料附送企業關係與技轉中心**，省略校內例行標準作業流程中委託專利事務所之專利前案檢索作業。

※請勾選經費來源，如不同國別欲以不同經費亦請敘明：

□現金 □節餘款(會計編號 ) □其他

甲方： 創作人代表： 系/所 教授 簽章　　　　 (日期 )

身份證字號：

乙方：國立成功大學 代表人：校長

依分層負責代為決行 企業關係與技轉中心主任 簽章　　　　 (日期 )

**備註：**創作人自費的**經費來源**： 個人計畫經費(計劃經費表需明列專利相關費用，**需排除科技部計畫**)或個人自有款項，例如：1. 以現金或支票至企業關係與技轉中心繳款；2.「創作人個人專帳\_節餘款」，需配合會計室承辦人要求（如：專簽說明）；3.院系所中心「管理費」、「節餘款」，創作人需經該經費所屬單位主管&會計室承辦人同意；4.廠商出資，務必留意合約智權歸屬相關約定。

**【衍生收益分配】**本校研發成果移轉授權、讓與及其衍生權益收入，包含協調、調解、和解、仲裁、訴訟等爭端解

決機制所得補償金、賠償金、和解金、違約金以及其他類似性質之收入，應扣除回饋資助機關(0

或20%)、專利成本、委託校外單位推廣費用(視需否)、企業關係與技轉中心服務成本(15%或

12%)。

**【各階段費用】**僅供參考，實際專利申請費用依該案委辦事務所之報價單為主。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 專利國別 | 專利申請費用 | 答辯1費用 | 答辯2費用 | 領證費用 | 總計(一次請購總額) |
| 台灣 | NT.35,000~45,000 | NT.15,000 | NT.25,000 | NT.10,000 | NT.85,000~95,000 |
| 美國 | NT.80,000~95,000 | NT.60,000 | NT.75,000 | NT.70,000 | NT.285,000~300,000 |
| 中國大陸 | NT.45,000~55,000 | NT.25,000 | NT.30,000 | NT.20,000 | NT.120,000~130,000 |
| 美國臨時案(PA) | NT.25,000~40,000 | ­­­­ | ­­­ | ­­­ | ­­­ |
| 其他國家專利費用 | 請電洽企業關係與技轉中心詢問 | | | | |

* 1. 創作人(發明人)基本資料 (超過一位時請自行增列表格，以每人一頁為原則，貢獻比合計應為100%)

第□位**(創作人代表)**，共□位

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 創作人中文姓名 |  | 貢獻比例 | □□% |
| 創作人英文姓名(護照名字) | \*若未填寫視同發明團隊每人均分 | | |
| 身分證字號 |  | | |
| 聯絡電話 |  | | |
| 傳真 |  | | |
| 電子郵件 |  | | |
| 戶籍地址 |  | | |
| 通訊地址 |  | | |
| 國籍 |  | | |
| 服務單位 |  | | |
| 職稱 |  | | |
| 聯絡人 |  | | |
| 聯絡人電話 |  | | |
| 聯絡人電子郵件 |  | | |

■ 本研究成果為創作人職務上發明。

* 本研究成果為創作人非職務上發明。
* 本人為創作人代表，代表其他創作人填寫此表，將來若有智財收益，由本人代表通知企業關係與技轉中心創作人間之分配比例。

創作人代表 簽名\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**[初稿尚不需簽名，請先E-mail至企業關係與技轉中心]**

第□位，共□位

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文姓名 |  | 貢獻比例 | □□% |
| 英文姓名(護照名字) | \*若未填寫視同發明團隊每人均分 | | |
| 身分證字號 |  | | |
| 聯絡電話 |  | | |
| 傳真 |  | | |
| 電子郵件 |  | | |
| 戶籍地址 |  | | |
| 通訊地址 |  | | |
| 國籍 |  | | |
| 服務單位 |  | | |
| 職稱 |  | | |
| 聯絡人 |  | | |
| 聯絡人電話 |  | | |
| 聯絡人電子郵件 |  | | |

■ 本研究成果為創作人職務上發明。

* 本研究成果為創作人非職務上發明。

創作人簽名\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**[初稿尚不需簽名，請先E-mail至企業關係與技轉中心]**

二、技術資料

1.背景說明 **(非機密性)**

【本項各欄位請勿填入機密性內容，本中心將視推廣之需將其引用於網頁或其他公開資料上】

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 技術名稱─中文 |  | |
| 技術名稱─英文 |  | |
| 所屬計畫名稱 |  | |
| 所屬計畫編號 |  | |
| 計畫資助機關 |  | |
| 研發領域  (非機密性)  (請先選大類再選細項，**可複選**)  (若無細項可勾選，請自行填於”其他”) | □工程科技 | □E11環境工程 □E09土木、水利工程 □E01機械固力 □E71航空科技 □E80海洋工程 □E03造船工程 □E17醫學工程 □E72熱傳學、流體力學 □其他\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| □化工材料 | □E02化學工程 □E06材料工程 □E20高分子與纖維 □E10能源科技 □E8 金屬及陶瓷材料工程 □其他\_\_\_\_\_\_ |
| □基礎醫學與醫藥 | □B1010基礎醫學 □B1030A0藥學 □BC生理 □BD藥理及毒理 □BE 醫學之生化及分子生物 □其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| □臨床醫學 | □1020臨床醫學 □復健科 □BN牙科 □骨科 □外科 □護理 □其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| □農業生物 | □B1植物學 □B2動物學 □B2010生物學 □B3010農業科技 □E07食品工程 □B8漁業  □其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| □資訊網通 | □E08資訊 □E12電信工程 □E60生產自動化技術 □其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| □電力電子 | □E14微電子工程 □E18電力工程 □E61控制工程 □其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| □光電與自然科學 | □E15光電工程 □M03物理 □M04化學  □M05地球科學□其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| □規劃設計與人文 | □H12心理學 □H16管理學 □工業設計  □其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| □其他 | □\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 智慧財產權歸屬 | ■本校 □科技部 □農委會 □其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □共有單位\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（持有比例\_\_\_%）(若從未約定比例者，免填比例) | |
| 目前智財權狀況 | □ 已進行專利保護，申請權人\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (請續填下一欄)  ■ 欲進行專利保護 (請務必詳填本申請表第四段2.3.4.內容)  (以上二項皆有者請都勾選) | |
| □ 於○○國家已獲得專利(專利證號\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  □ 於○○國家專利申請中  (請將相關之各國專利證書影本、專利公報、或代理之專利事務所資料等列入本表附件) | |

***以下淺綠底色標示欄位企業關係與技轉中心將用於產學雲端平台推廣使用：□同意 □不同意***

|  |  |
| --- | --- |
| 中文摘要(500字)  (非機密性) | (推廣用，請勿填入機密性內容) |
| 英文摘要(500字)  (非機密性)  (提供企業關係與技轉中心用於英文推廣平台) | (推廣用，請勿填入機密性內容) |
| 現有技術描述 | (若本技術存在相應的最相近現有技術，請說明該現有技術方案與內容) |
| 現有技術問題及其缺陷描述 | (請說明該現有技術方案的問題及缺陷，例如：難以操作使用、成本高、效益低) |
| 本技術發明目的、所欲解決之問題、能提昇的功效 | (請說明本技術發明之目的、解決了現有技術方案的何種問題，以及提供了哪些功效) |
| **Benefits**  (提供企業關係與技轉中心用於英文推廣平台) | (請以英文填寫) |

2.本技術內容

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本技術之發明標的 (可複選) | | | | |
| 類型 | □ Process  (方法、程序) | □ Machine  (機器、設備) | □ Manufacture  (製品) | □Composition of Matter (組合物) |
| 定義 | 一種動作/行為，或一連串的動作/行為。 | 一種具體的物件，其包含了零件/部件/組件，或由某些儀器裝置及儀器裝置的組合所構成 | 透過人力或機器，賦予原料或備料一種新的狀態形式、特質、特性或各種變化的組合，而所產生的產物 | 所有兩種以上的物質之組合，或者複合式物件，這些物質之組合或複合式物件可以透過化學結合或機構機器的組合達成，包含原子之組合排列所形成的化學物質。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 本技術內容  （請結合圖/表詳細描述本技術的內容，且圖/表應條列於(五)）  (機密性) | (請依據「本技術之發明標的」項目，詳細說明本技術內容。例如：勾選Process，請詳細說明本技術發明之實施步驟、流程及方法，並於右邊欄位提供流程圖；如勾選Composition of Matter，請提供化學式、混合物之成份、比例等，並於右邊欄位提供化學結構圖。如勾選複數標的，請針對所有標的提供所說明，例如同時選取Process及Composition of Matter，兩項標的都須提供說明。另，請說明本技術發明運作原理機制、實驗方法、臨床實驗、實驗結果、功效及應用等詳細資訊) |
| 本技術的實施方式 | (請儘可能舉例所有本技術可具體實施的方式)  實施方式一： |
| 實施方式二： |
| 實施方式三：  (如超過三種實施方式，請自行增列說明) |
| 實施本技術的必要技術特徵  (機密性) | (請條列式列出實施本技術發明，可達到技術功效、最少且必要的步驟、流程、方法、技術元件、機械結構、化學結構及技術特徵等) |
| 與現有技術的關鍵技術特徵區別  (機密性) | (請說明本技術發明，與現有技術的區別技術特徵) |
| 相關學術文獻（論文期刊等） |  |
| （論文期刊等）中、英文關鍵字 |  |

三、技術推廣

1.技術價值自評

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 評估項目 | | 說明 | 自評區 | 備註 |
| 專利經濟價值 | 保護範圍 | 利用他人技術迴避之難易度（被替代性） | □ 無法迴避  □ 有點困難  □ 容易迴避 | 其它說明： |
| 競爭性 | 分析本技術對於市場競爭的影響 | □ 對同領域/競爭對手/上下游有干擾作用  □ 具授權/交互授權/技術移轉可能性  □ 對同領域/競爭對手/上下游無束縛能力 | 其它說明：  \*請配合後面欄位『3.2可能運用對象』說明 |
| 與業界最新技術比較 | □ 具有絕對優勢  □ 若干優勢  □ 無優勢 | 其它說明： |
| 可實施性 | 實際產業應用的可能性 | □ 可立即實施  □ 有待檢討  □ 無 | 其它說明： |

2.產業應用自評

***以下淺綠底色標示欄位企業關係與技轉中心將用於產學雲端平台推廣使用：□同意 □不同意***

|  |  |
| --- | --- |
| 產業應用性  (非機密性) | (請列舉本技術適用的潛在或已知應用的產業、產品與技術領域及其相應之應用方式) |
| 適用產業類別  (非機密性) | (請列舉本技術適用的潛在或已知應用的產業類別) |
| Possible Applications/Industry Categories  (提供企業關係與技轉中心用於英文推廣平台) | (請以英文填寫) |
| 未來收益的可能性（例:技轉金額預估值等） | （在本申請表第四段『4.欲申請專利』有勾選國外專利者，本欄位為必填） |
| 可能運用本發明之公司及聯絡對象並說明其產品/技術現況 |  |
| 其它推薦資訊 |  |

四、申請專利資料

1.相關專利資料

|  |  |
| --- | --- |
| 本人專利清單  (就本案技術領域，請列舉您目前所擁有之相關專利)  (\*包含申請中案件) |  |
| 建議的專利資料庫檢索之中、英文關鍵字 |  |

2.可專利性自評 【本項為欲申請專利者才需填寫】

| 評估項目 | | 說明 | 自評區 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 專利基本要件 | 產業上利用性  （實用性） | 可供產業上利用，且可反覆實施而均達成相同功效 | □ 可立即實施  □ 實驗室階段  □ 構想階段 | 其它說明： |
| 新穎性 | 技術未被自己/他人發表/使用/出版/申請專利 | □ 充分新穎性  □ 部分新穎性  □ 不具新穎性 | 其它說明： |
| 進步性 | 與先前技術相較，就本領域技術人士觀之，係屬非顯而易知者 | □ 具前瞻進步性  □ 部分進步性  □ 不具進步性 | 其它說明： |
| 專利技術 | 技術領先性 | 分析在相關領域技術的領先程度 | □ 非常領先  □ 部分領先  □ 無 | 其它說明： |
| 專利周延性 | 獲准專利後，遭他人技術舉發而危及專利權之可能性 | □ 不容易遭舉發  □ 容易遭舉發 | 其它說明： |
| 侵權可能性 | 技術遭侵害時的辨識程度 | □ 易於發現侵權事實  □ 需經還原方式始能發現侵權事實  □ 不易發現侵權事實 | 其它說明：  \*若勾選”不易”，建議用營業秘密保護 |

3.公開揭露紀錄 【本項為欲申請專利者才需填寫】

|  |  |
| --- | --- |
| 是否已公開？ | □ 是　■ 否，未來會公開　 □ 否，未來亦無公開之計畫（選本項者，以下日期、目的及方式免填）  \*我國發明專利”優惠期”之規定為12個月，若於公開後才申請專利，必須於優惠期到期前正式送入我國智慧局。 |
| 已(或預計)公開之方式 | □ 學位論文 □ 國內外期刊 □ 技術公開演說  □ 其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 已(或預計)公開之日期  （請依上欄勾選的項目填寫日期） | □ 論文口試日\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　□ 繳交論文日\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □ 期刊(預計)投稿日\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ □ 期刊(預計)出版日\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □ 技術演說日\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(活動型式\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  □ 其他  \*期刊已投稿或即將投稿是影響新穎性之重要因素，請務必詳實選填！  若已知投稿日或即將投稿，請務必告知企業關係與技轉中心及專利事務所工程師。 |
| 已(或預計)公開之內容和本專利內容之差異 |  |

4.欲申請補助項目說明

|  |  |
| --- | --- |
| 項目 | ■中華民國專利 □美國專利 □其他專利國別\_\_\_\_\_\_\_(■發明 □新型 □設計)  □其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 申請理由 | (必填，至少應說明欲申請上述專利國別的理由) |

五、圖表列表：請將本申請表中所有使用之圖、表、圖片、照片依出現順序編號並列表簡述

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 請選至少一非機密性之圖或照片，以便推廣用 | 編號 | 說明 |
| □ | F001 |  |
| □ | F002 | (請自行增列) |

六、其他重要事項點檢表 【請自行增減勾選之項目】

* 本研究室有撰寫研究紀錄簿(或稱研發日誌)並妥善留存。

□本案屬科技部研究計畫衍生的成果，已同時檢附計畫核定清單(pdf)給企業關係與技轉中

心。

七、附件 【請自行增減勾選之項目】

■ 本申請表中所使用之圖、表、圖片、照片

(請自下頁起依序放置本申請表第五段所列圖表，並標示編號及說明。請以高解析黑白顯示)

□ 自行檢索獲得之相關專利資料**（當創作人選擇完全自費且考量專利案處理時效，要求省略由企業關係與技轉中心依例行標準作業流程中委託專利事務所之專利前案檢索作業者，此為必要附件）**

□ 已進行保護之專利案件相關資料

(例如︰專利證書影本、專利公報影本、代理事務所資料)

□ 計畫核定清單**（如屬於科技部計畫之成果，此為必要附件）**

□ 計畫合約書影本（如產學合作計畫、建教合作計畫或其他計畫）

□ 學術研究報告（如計畫結案報告、論文）

□ 其他

填表人(創作人代表)：

本人保證上述資料正確無誤。簽名\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 日期\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**[初稿尚不需簽名，請先E-mail至企業關係與技轉中心]**